

深圳市崇达电路技术股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分 析报告

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	崇达技术总部运营及研发中心	深圳崇达多层线路板有限公司	41,785.09	28,000.00
2	超大规格印制线路板技术改造项目	大连崇达电路有限公司	20,000.00	20,000.00
3	高多层线路板技术改造项目	江门崇达电路技术有限公司	21,939.11	20,000.00
4	补充流动资金	深圳市崇达电路技术股份有限公司	12,000.00	12,000.00
合计			95,724.20	80,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募资资金投资项目的实施背景

（一）行业背景

1、PCB 下游应用领域广泛，全球 PCB 行业前景广阔

PCB 下游产业涵盖范围相当广泛，包括计算机、通信终端、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、国防、航空航天等领域。根据 PrismaMark 预测，全球 PCB 应用领域中，计算机领域的 PCB 市场规模最大，占比约为 29%；其次

为通信领域，占比约为 28%；其他为 IC 载板、消费电子、工控及医疗、汽车电子和军事航天等领域。

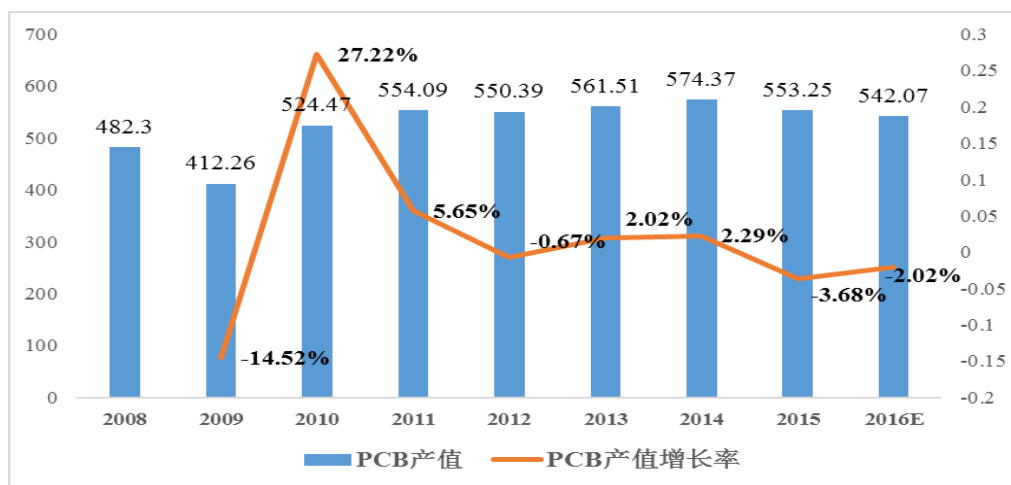
PCB 行业需求回暖，进入新一轮景气周期，多个细分行业的 PCB 下游需求市场实现两位数的年增长速度，成为 PCB 行业增长新动能。汽车电子化趋势带动车用 PCB 市场快速发展，车用 PCB 市场规模高达千亿，认证周期长、门槛高；新能源汽车带来 PCB 需求百亿增量市场；小间距 LED 市场快速扩张，多层 PCB 板需求旺盛；移动通讯技术日新月异，高密度小基站建设带动高附加值 PCB 需求；中国高端服务器市场速增长，所需 PCB 附加值日益提高。

汽车和通信是增长最快的应用领域。随着车联网、汽车智能化的发展，汽车电子的成本占比日渐提高。根据 PW 统计，目前通车型汽车电子成本占比约为 25%，未来有望提升到 50%以上。此外，随着元器件的增多，汽车电子也向集成化、网路化发展。根据德勤测算，2016 年全球汽车电子规模达到 2348 亿美元。2013-2015 年中国 4G 投资增长率高速增长，复合增长率为 59%，2015 年达到 1,048 亿元。三大运营商有可能在 2018 年展开 5G 网络建设，根据以往经验，三大运营商前两阶段的网络建设投资将不低于 4G 网络建设，其总额将超过 3,000 亿元，通信市场的投资在 5G 的带领下有望继续高速增长。

根据 Prismark 预测，全球 PCB 产业未来仍将稳步发展。全球 2016 年 PCB 总产值达 542.07 亿美元，预计 2017 年增长率将达 2.0%，2016-2021 年 PCB 总产值年均增长率（CAAGR）将达 2.2%。

全球 PCB 产值及增长情况

单位：亿美元



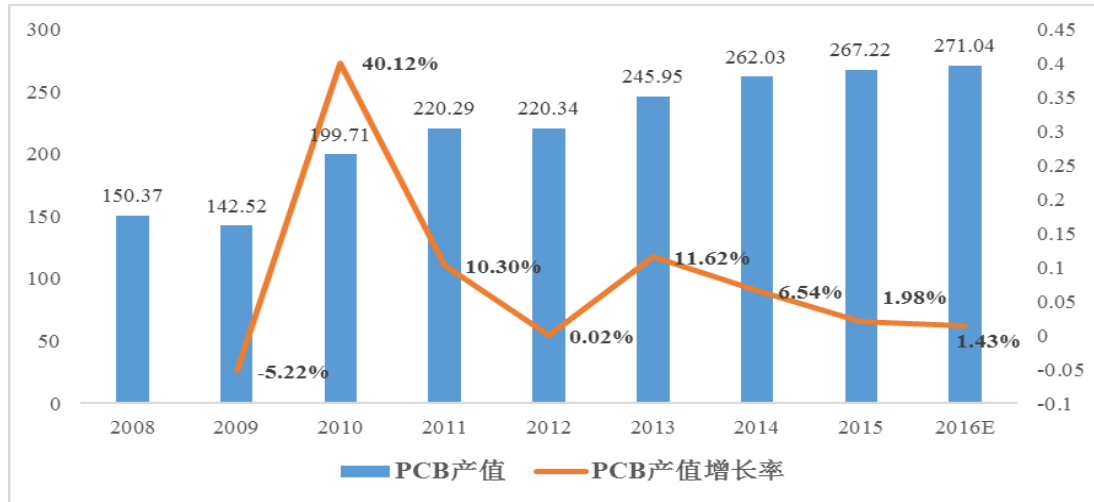
数据来源：Prismark 2017.3

2、中国 PCB 行业将保持持续稳定增长

中国 PCB 行业近年来整体发展迅猛。根据 IPC 统计，2006 年我国 PCB 行业产值达到 121 亿美元，占全球 PCB 总产值的比例约为 25%，自此成为全球 PCB 最大生产国。根据 PrismaMark 预测，2016 年中国大陆 PCB 产值达 271.04 亿美元，年增长率为 1.43%，占全球 PCB 总产值的比例约为 50%，2016-2020 年中国 PCB 行业产值的年复合增长率将达 2.96%。

中国 PCB 产值及增长情况

单位：亿美元



数据来源：PrismaMark 2017.3

3、高层板、HDI 板、挠性板等应用需求增加，未来增长空间较大

随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化应用日益广泛。电子产品对 PCB 板的高密度化要求更加突出；高层板、HDI 板、IC 载板、挠性板、刚挠结合板等高端 PCB 产品开始占据整个 PCB 市场的主导地位。HDI 板和挠性板是增长最快的产品。普通的单面板和双面板处于生命周期的成熟期，由于 PCB 生产工艺的发展和产品成本等因素，单双面板市场需求规模将在未来较长时期内继续保持稳定；普通多层板处于逐步成熟阶段，随着电子产品性能增强，市场需求将不断增加；高频板、HDI 板等则处于快速成长期，产品技术逐步成熟、市场需求将显著增加；铝基板、光电板、芯片封装板等产品尚处于市场导入期，未来发展空间较大。

根据 PrismaMark 预测，2017 年挠性板的产值年增长率为 4.1%，增长幅度在五大 PCB 品种中最高，并将于 2021 年成为需求增长最大的品种；挠性板产值占各

类品种总产值的比例，将由 2016 年的 20.10%增长至 2021 年的 20.90%。尽管 HDI 板在 2016 年出现产值的负增长，但从未来几年的市场发展前景来看，其未来增长仍较乐观。2017 年 HDI 板年增长率将达到 2.9%，其 2016-2021 年产值年均增长率（CAAGR）为 2.8%，仅次于挠性板产值增长率而居行业第二。

4、国内 PCB 行业内公司业绩快速增长

中国正在成为电子产品制造大国，全球 PCB 产能也在向中国转移，不仅外资企业加速向中国转移，内资 PCB 企业产能增长也十分迅速，自 2006 年以来，中国已经成为全球 PCB 行业最大的生产国。国内 PCB 企业具备成本、产业链双重优势，在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面更有优势，从而不断成为全球 PCB 行业内的重要参与者。

从 PCB 产业转移的动态来看，国内 PCB 企业正处于上升趋势，特别是内资 PCB 企业的业绩和收入规模增长速度远高于行业的整体增长速度，内资企业逐渐获取台资、日资等企业的市场份额。根据 N.T.Information 2016 年 7 月发表研究报告《NTI-100 2015 World Top PCB Makers》可知，2015 年全球 PCB 百强中，中国的 PCB 企业共 34 家，成为了 PCB 行业中重要的市场力量。

（二）政策背景

PCB 是现代电子设备中必不可少的基础元件，我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策以扶持与鼓励 PCB 行业发展。

时间	文件名称	发文单位	相关内容概要
2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	信息产业部	提出重点围绕计算机、网络和通信、数字化家电、汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需求，发展相关的片式电子元器件、机电元件、印制电路板、敏感元件和传感器、频率器件等新型电子元器件，并将多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制线路板技术列为重点发展的技术。
2009年	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。
2011年	《当前优先发	发改委、科技部、工	将高密度多层印刷电路板和柔性电路板列

时间	文件名称	发文单位	相关内容概要
	展的高技术产业化重点领域指南》	信部、商务部和知识产权局	为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。
2012年	《电子信息制造业“十二五”发展规划》之子规划1:《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》	国家工业和信息化部	将加强高密度互连板、特种印制板、LED用印制板的产业化,研发印制电子技术和光电印制板并推动产业化作为发展重点。
2015年	产业结构调整指导目录(2015年本)	国家发改委	将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造类为信息产业行业鼓励类项目。
2015年	《外商投资产业指导目录(2015年修订)》	国家发改委和商务部	将新型电子元器件制造:片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板列为鼓励外商投资产业。
2016年	《国家重点支持的高新技术领域》	国家科技部和商务部	将中高档机电组件:超小型、高可靠、高密度的高速连接器制造技术;新型高可靠通信继电器制造技术;小型化组合式大电流继电器制造技术;高可靠固体光/MOS继电器制造技术;高保真、高灵敏、低功耗电声器件制造技术;刚挠结合板和HDI高密度积层板技术等列入国家重点支持的高新技术领域。
2016年	《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》	国家发改委、财政部和商务部	将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造(C27)列为鼓励发展的重点行业。

(三) 公司经营背景

本公司是国内小批量板行业的领先者,凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力。在PCB产业转移的背景下,本公司成功开拓了海外市场,近几年出口比例一直在70%以上;而在国内,随着医疗仪器、工业控制、安防电子等存在小批量板需求的下游行业的迅猛发展,本公司专业、专注的竞争优势将在未来得到充分体现。但公司在发展过程中面临了如下问题:

1、公司现有办公面积不足，租赁厂房存在搬迁风险。深圳崇达现有厂房及办公场所均为租赁场所，但因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，因此存在可能搬迁的风险，从而对公司的正常经营产生不利影响。

2、PCB 行业对所属行业内的公司的研发能力、持续创新、生产效率等提出了较高的要求。目前公司主要产品为小批量多层线路板，随着市场需求的进一步增长，高端小批量特种 PCB 等产品的需求不断增加，公司的高端小批量特种 PCB 等产品的生产效率亟待提升。

3、公司所处行业为技术、人才密集型行业，强大的技术研发能力是公司保持市场竞争力与行业地位的关键。为了保持公司在小批量 PCB 行业的持续领先地位，公司营运资金需求不断增长。

三、本次募资资金投资项目的必要性分析

（一）崇达技术总部运营及研发中心项目

1、公司现有办公面积不足，亟待建设总部运营及研发中心

截止目前，公司尚未有具有自有产权的总部运营办公场所。公司现在宝安区沙井新桥新玉路横岗下工业区租赁标准厂房，用于深圳崇达的生产及深圳崇达、崇达技术办公场所，办公场所分布于各租赁厂房内，且与生产场所同处一栋厂房内。截至 2016 年底，深圳崇达及崇达技术员工共 1,500 余人，办公、研发场所已显紧张；未来，随着公司业务规模不断扩大，办公、研发人员还将进一步增加。因此，公司的办公、研发场所规模亟需扩大。本项目的建设将很好地解决公司中长期办公、研发场所紧缺的局面，为员工提供良好的办公和研发环境。

2、防范租赁厂房搬迁风险，减少租金支出

深圳崇达现有厂房及深圳崇达、崇达技术的办公场所均为租赁场所。深圳崇达租赁的生产经营用厂房租赁合同均已根据相关法律法规在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理备案登记，但因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，因此存在可能搬迁的风险，从而对公司的正常经营产生不利影响。

为了能有一个稳定的办公场所，防范可能突然出现的搬迁风险对公司经营活动的不利影响，本项目的建设具备必要性。项目建成后，总部运营及研发中心为

公司自建房产，不存在突然的搬迁风险，将为深圳崇达及崇达技术提供稳定的办公、研发场所，且可以减少房屋租金支出。

3、提升研发实力，持续推进产品创新

公司主要从事于小批量 PCB 的设计、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，也已发展成为国内领先的小批量 PCB 板生产企业，形成了明显的竞争优势，并具备了参与全球竞争的实质。本项目建成，可以为公司提供稳定的研发场所，从而进一步提升研发实力，持续推进公司产品创新。

(二) 江门崇达及大连崇达技改项目

1、提升公司提高生产效率和运营效率

公司所处小批量板行业属于 PCB 细分行业之一。与大批量板生产厂商相比，小批量板生产厂商客户更为分散，平均订单面积更小，订单品种更多，对订单反应速度、生产管理、订单处理及交货期要求更高。随着行业竞争的日趋激烈，对公司的生产和管理水平提出了更高的要求。为应对上述行业变化，公司提出了对江门崇达及大连崇达原有工厂进行技术改造。技术改造项目可以通过新增国内外先进的工艺设备，替换原有部分工序的部分设备，改进工艺流程，提升工艺技术水平，从而提高公司生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提高产品的良率和质量，进一步提高公司核心竞争力。

2、优化产品结构，提高高端市场的占有率

由于国内小批量特种 PCB 板生产企业中大部分企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，因此高端产品产能增长有限。但随着下游行业的快速发展，高端小批量特种 PCB 板的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数具有技术领先优势的企业，已具有能够规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力，目前公司的主要产品为小批量多层线路板。随着市场需求的进一步增长，公司的高端小批量特种 PCB 的产能已不能满足高端市场快速发展的需求，因此，公司需要进一步优化产品结构，提高高端产品的占比。

江门崇达高多层线路板技术改造项目，系在现有小批量 PCB 主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑国内外同类产品的发展方向，改进工艺技术，提升高端小批量特种 PCB 产品的生产效率。大连崇达超大规格印制线路板技术改造项目，系在大连崇达现有生产厂房内新购置、安装生产工艺设备，以替换原有部分工序的部分设备，提升超大规格印制线路板的能力及工艺技术水平。通过江门崇达和大连崇达技改项目的实施，公司将进一步优化产品结构，加大生产技术含量更高、盈利能力更强的高端小批量特种 PCB 板的比重，增强核心竞争力，为公司的未来发展奠定良好的基础。

3、巩固公司在国内小批量 PCB 行业的领先地位

公司主要从事于小批量 PCB 的设计、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，也已发展成为国内领先的小批量 PCB 板生产企业，形成了明显的竞争优势，并具备了参与全球竞争的实力。

由于小批量 PCB 市场具有良好的发展空间，为了保持公司在小批量 PCB 行业的持续领先地位，公司需要在经营规模、生产效率、产品结构和技术实力等方面进行全方位的提升。通过江门崇达和大连崇达技改项目的实施，在经营规模、产品档次、技术实力、管理能力等方面将迈上新的台阶，将有利于缩小公司与国际知名小批量 PCB 企业在规模、技术等方面的差距，公司的产品国际竞争力将大大增强，公司在国际上的品牌知名度将得到大幅提升，公司的核心竞争力和领先的市场地位将得到进一步的巩固。

（三）补充流动资金项目

随着公司的持续快速发展，业务规模持续扩大，公司对资金的需求逐渐增加，资产负债率维持在较高的水平。2014 年末、2015 年末、2016 年末以及 2017 年 3 月末，公司合并口径的资产负债率分别为 44.62%、47.57%、38.09%、44.92%，高于同期的同行业上市公司平均水平。公司所处行业为技术、人才密集型行业，强大的技术研发能力是公司保持市场竞争力与行业地位的关键。伴随本次其他募投项目的推进，未来公司将持续专注于 PCB 行业，不断推出新产品，加大高端人才培养与引进力度，维持公司的核心技术优势。因此，公司未来运营资金需求

会不断增长。

公司拟使用部分募集资金补充流动资金，将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目的可行性

（一）公司拥有高素质员工团队和研发人员储备

截至 2017 年 3 月 31 日，公司（含所有子公司）员工总数达到 3,950 人，通过不断的外部招聘和内部培养，形成了一支在 PCB 行业内，就管理、研发、生产、销售等各环节拥有专业水平和实践能力的高素质员工团队，能够为募投项目的顺利实施提供保障。

（二）公司拥有丰富的产品技术储备及成熟的生产技艺

公司自创立以来，主要从事于小批量板的生产与销售，紧跟国际先进技术的发展，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2017 年 3 月 31 日，发行人及子公司共获得专利 200 余项（其中发明专利 50 余项），软件著作权 20 余项。公司所发表的论文能够围绕高新技术和产品展开，有效体现公司技术水平。同时，公司也在积极与华中科技大学等院校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新性研发机制。

公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达均被认定为高新技术企业，公司荣誉和认证众多，包括：深圳崇达技术中心被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的《实验室认可证书》（注册号：CNASL6774）。

综上，公司技术储备实力雄厚，募投实施主体均为高新技术企业，可确保公司针对行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，为项目的顺利实施提供重要保障。

（三）公司拥有丰富的客户资源和强大的市场开发能力

本公司是国内小批量板行业的领先者，深耕 PCB 行业二十余年，公司以快速响应、品质可靠、价格合理等综合优势，与 PCB 行业国内外知名企业建立战略合作关系；与此同时，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，在 PCB 产业转移的背景下，本公司成功开拓了海外市场，海外行业内知名客户群不断丰富，公司近年来，海外销售比例一直在 70% 以上。

整体而言，受益于医疗仪器、工业控制、安防电子等存在小批量板需求的下游行业的迅猛发展，公司凭借产品和技术优势，公司客户优势愈发凸显，逐渐积累了质量优良、发展潜力大的优质客户群。截至 2016 年末，公司客户数量达到 1,107 个，涵盖了部分世界五百强企业 and 知名上市公司。广泛的客户数量及高品质的客户为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以顺利保障募投项目的实施。

五、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）崇达技术总部运营及研发中心建设项目

1、项目建设地点及实施主体

项目建设地点：深圳市光明新区高新技术产业园内。项目拟用地面积为 5,731.82 m²，拟建筑总建筑面积为 34,384 m²。

项目实施主体：深圳崇达多层线路板有限公司。

2、项目建设内容

崇达技术总部运营及研发中心建设项目，建设办公运营和研发中心。

3、项目建设期

项目建设周期为 3 年。

4、项目投资估算

项目总投资为 41,785.09 万元，其中拟利用募集资金投入 28,000.00 万元，自筹资金 13,785.09 万元。

5、项目经济效益评价

本项目的建设可进一步扩大公司的办公面积，提升研发技术实力，为员工提供一个良好的办公和研发环境，吸引更多、更好的人才为公司服务；同时避免因房屋租赁到期而影响公司生产办公，减少公司租金支出，大大提升崇达技术形象。

6、项目涉及的政府报批情况

本项目已经取得深圳市光明新区发展改革委员会备案文件（备案编号为：深光明发财备案【2017】0016号），同时已经取得了深圳市环境保护和水务局出具的深圳市建设项目环境影响登记表网上回执（备案号：BAGM201700125），并已经与深圳市规划和国土资源委员会光明管理局就相关土地（宗地编号：A646-0062）签订了《深圳市土地使用权出让合同书》（合同号：深地合同（2016）7016号）。

（二）大连崇达电路有限公司超大规格印制线路板技术改造项目

1、项目建设地点及实施主体

项目建设地点：本项目建设地块位于大连市金州新区小窑湾片区大连崇达电路有限公司 PCB 生产基地内实施。

项目实施主体：大连崇达电路有限公司。

2、项目主要建设内容

本项目是超大规格印制线路板技术改造项目，项目拟在大连崇达现有生产厂房内，引进先进智能的自动化设备，更新效率低下的老旧设备，以提升企业生产效率，增强企业竞争力。

3、项目建设期

项目建设期为 2 年。

4、项目投资估算

项目总投资为 20,000.00 万元，其中拟利用募集资金投入 20,000.00 万元。

5、项目经济效益评价

本项目全部建成并达产后，预计实现年均销售收入 16,850 万元（不含税），年均净利润 2,528 万元，项目投资回收期 6.35 年（税后），财务内部收益率 15.32%（税后）。

6、项目涉及的政府报批情况

本项目已经取得大连光明金普新区商务局备案文件（备案编号为：大金商普技改备【2017】8号），环评的相关政府审批事项正在办理中。

（三）江门崇达电路技术有限公司高多层线路板技术改造项目

1、项目基本情况

项目建设地点：本项目建设地块位于江门市高新技术产业园江门崇达电路技术有限公司 PCB 生产基地内。

项目实施主体：江门崇达电路技术有限公司

2、项目主要建设内容

本项目为高多层线路板技术改造项目，项目将利用江门崇达一厂现有生产厂房，引进先进智能的自动化设备，更新效率低下的老旧设备，以提升企业生产效率，增强企业竞争力。

3、项目建设期

项目建设期为 2 年。

4、项目投资估算

项目总投资 21,939.11 万元，其中拟利用募集资金投入 20,000.00 万元，自筹资金 1,939.11 万元。

5、项目经济效益评价

本项目全部建成并达产后，预计实现年均销售收入 15,405 万元（不含税），年均净利润 2,402 万元，项目投资回收期 6.60 年（税后），财务内部收益率 13.79%（税后）。

6、项目涉及的政府报批情况

本项目的报批事项正在办理中。

（四）补充流动资金

随着公司业务和收入规模不断扩大，日常经营所需的资金需求不断增加，公司计划将 12,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，并提高公司的盈利水平。

1、公司业务和收入规模持续增长，未来业务发展的资金需求增加

公司是国内小批量板行业的领先者，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力。同时，受益于行业下游需求旺盛，加之公司产品质量优良，客户群不断丰富，公司营业收入持续增长，公司盈利能力不断增强。随着公司营业收入实现稳步增长，营业利润、利润总额、净利润亦持续保持增长。其中，2014年、2015年、2016年以及2017年1-3月公司的营业收入金额分别为159,086.02万元、175,694.18万元、224,661.19万元、68,588.10万元；2014年、2015年、2016年以及2017年1-3月公司的净利润金额分别为27,353.89万元、30,088.23万元、37,575.34万元、9,556.64万元。公司收入和利润规模不断增长，对资金的需求日益凸显。

2、降低财务费用，提高公司盈利能力

截至2017年3月31日，公司的合并报表流动负债金额为142,734.98万元、非流动负债金额为21,867.90万元、财务费用为685.69万元，由于可转债的利息成本相对较低，本次公开发行可转债所募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定缓解，并可以一定程度降低公司财务费用，提高公司整体盈利能力。

六、本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

1、本次发行对公司经营的影响

公司总部运营及研发中心建设项目的实施将很好地解决深圳崇达及崇达技术中长期办公、研发场所紧缺的局面，为深圳崇达及崇达技术的生产、办公和研发提供稳定、良好环境，同时亦将减少相应的房屋租金；江门崇达技改项目和大连崇达技改项目均是在公司现有生产线基础之上，进行升级改造，通过引进国内外先进的生产设备，替换原有部分设备，升级现有工艺流程，产品工艺流程和自动化水平进一步优化和提升，提高生产效率和公司整体运营效率，优化公司现有产品结构，提升高端产品的收入占比；补充流动资金项目的实施将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

本次募集资金投资项目建成后，将为公司提供稳定的办公和研发环境，提升

公司研发实力，进一步巩固公司现有优势产品的市场地位，提升小批量板的市场占有率，优化公司产品结构，增强公司盈利能力，同时进一步提升公司影响力和市场价值，有利于公司全方面实现健康、均衡、持续的发展目标。

2、本次发行对公司财务的影响

本次可转债发行完成后，短期内公司的总资产、负债规模均将有所提升。本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。

可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施有所增加。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险。

七、综述

综上所述，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、市场竞争格局和公司自身优势等因素的综合考虑，并通过了必要性和可行性的论证。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，符合公司制定的战略发展方向，有利于增强公司的可持续竞争力，符合本公司及全体股东的利益。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

2017年7月19日